

パワーデバイス用途 熱伝導タイプ封止材

Molding Materials for Power device

放熱性に優れ、パワーデバイスに最適

Superior Material for Power Device by Good Heat dissipation

		KMC-630 (Benchmark*)	KMC-4500C	KMC-4800	KMC-4800F	
熱伝導率 Thermal Conductivity		W/mK	3.5	2.5	3.5	3.0
スパイラルフロー Spiral Flow		175℃/90sec cm	50	50	50	75
ゲル化時間 Gelation Time		175℃ sec	20	28	25	40
溶解粘度 Viscosity		175℃ Pa·s	40	50	100	45
ガラス転移点 Tg		℃	175	160	155	135
線膨張係数 CTE	< Tg	ppm	15	20	12	18
	> Tg	ppm	45	55	48	36
曲げ強度 Flexural Strength		MPa	120	150	115	90
曲げ弾性率 Flexural Modulus		GPa	30	22	18	14.6
成形条件 Molding Condition		—	175℃ × 90sec		175℃ × 180sec	
ポストキュア条件 PMC Condition		—	180℃ × 4hr			

*Non Green Material

■ 高熱伝導材料 信頼性試験

High Thermal Conductive Material: Reliability test

Test Information

Package Type: TO-220

Molding Condition: 175°C/180sec

PMC Condition: 180°C/4hr

Test	KMC-630 (Benchmark)	KMC-4500C	KMC-4800	KMC-4800F
Condition ①	1000hr Pass	1000hr Pass	1000hr Pass	1000hr Pass
Condition ②	1000hr Pass	1000hr Pass	1000hr Pass	1000hr Pass
PCT	1000hr Pass	1000hr Pass	1000hr Pass	1000hr Pass
TCT: -55°C ↔ 150°C	500cycle Pass	500cycle Pass	500cycle Pass	500cycle Pass

Condition ①: 150°C 600V ⇒ No short, No crack, No delamination

Condition ②: 85°C/85%RH 600V ⇒ No short, No crack, No delamination

PCT ⇒ No crack, No delamination

TCT ⇒ No crack, No delamination

お問い合わせ



Contact us

ShinEtsu 信越化学工業株式会社

有機複合材料事業部

Organic Hybrid Materials Division

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング

TEL : 03-3246-5231 FAX : 03-6812-2419

4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

TEL : 81-3-6812-2426 FAX : 81-3-6812-2419

<https://www.shinetsu-encap-mat.jp>

Webは
こちら

信越化学 封止材

検索